

2021年度 製造中核人材育成セミナー日程

	1日目 (火)	(プロセス)	2日目 (水)	(プロセス)	3日目 (木)	(プロセス)	4日目 (金)	(プロセス)
9:00			プロセス講義 (馬場)		プロセス講義 (馬場)		プロセス講義 (馬場)	
				37. p-ch S/Dフォトリソ (吉田・城戸)				52. 配線フォトリソ (吉田・城戸)
			実習生プロセス (佐藤) ・フォトリソ (2回目)		休憩			
10:00					装置説明 (CR) (佐藤) ・RCA洗浄	43. RCA洗浄 (吉田・城戸)		
	開始 10:30 御挨拶 (中村センター長)		装置説明 (佐藤) ・イオン注入装置 実習生プロセス (佐藤) ・イオン注入	38. p-ch S/Dインプラ (吉田・城戸)	実習生プロセス ・RCA洗浄 (佐藤) ・拡散炉 (佐藤) ・PE-CVD (佐藤)		実習生プロセス	53. Alエッチング (吉田・城戸)
	オリエンテーション (馬場)	予備時間				44. S/D活性化熱処理 (吉田・城戸)	・フォトリソ (4回目) (佐藤) ・MetalRIE工程 (佐藤) ・レジスト除去 (WET) (佐藤) ・Alシンタリング (佐藤)	54. フォトレジスト除去 (吉田・城戸)
	安全教育 (馬場)			デバイス講義 (馬場)	39. フォトレジスト除去 (吉田・城戸)			55. シンタリング (吉田・城戸)
	クリーンルーム入室・見学 (馬場・佐藤)					プロセス講義 (馬場)	45. 酸化膜堆積 (吉田・城戸)	
12:00	昼食 Lunch	予備時間	昼食 Lunch	予備時間	昼食 Lunch	予備時間	昼食 Lunch	測定 (吉田・城戸・梅村)
13:00	進捗状況説明・プロセス講義 (馬場)		設計講義 (中村)	40.n-ch S/Dフォトリソ (吉田・城戸)	実習生プロセス (佐藤) ・PE-CVD ・フォトリソ (3回目) ・エッチング (2回目)	46. コンタクトフォトリソ (吉田・城戸)	周辺装置実習 ・ダイサー (佐藤) ・ワイヤーボンディング (佐藤)	・ウエハダイシング ダイシング (佐藤)
						47. 酸化膜エッチング (RIE)	測定実習説明 (中村) ・測定デバイス、結果予測など	測定 (吉田・城戸・梅村)
14:00	装置説明 (CR) (佐藤) ・フォトリソグラフィ 実習生プロセス (佐藤) ・フォトリソ (1回目)	34.ゲートフォトリソ (吉田・城戸)	個別装置実習 (佐藤) ・マスクレス露光装置	41. n-ch S/Dインプラ (吉田・城戸)	装置説明 (CR) (佐藤) ・スパッタリング	48. 酸化膜エッチング 49. フォトレジスト除去 (吉田・城戸)	休憩	
			休憩		実習生プロセス (佐藤) ・スパッタリング工程		測定実習 (中村) ・p-MOS、n-MOS、リングオシレー タなど測定	測定 (城戸・梅村)
15:00	休憩		クリーンルームユーティリティ見学 (中村)		休憩			・譲渡CD-ROM作成 (吉田・城戸)
	プロセス講義 (馬場)	35.Poly-Siエッチング 36. フォトレジスト除去 (吉田・城戸)			CMOS周辺装置実習: FIB-SEM (佐藤) ・FIB-SEMの紹介 ・既存CMOSチップの観察、FIB加工	50. HF洗浄 51. Al堆積 (吉田・城戸)	まとめ (中村センター長) 修了証授与 終了16:00	
16:00	装置説明 (CR) (佐藤) ・RIE装置 実習生プロセス (佐藤) ・エッチング ・フォトレジスト除去		プロセス講義 (馬場)	42. フォトレジスト除去 (吉田・城戸)	プロセス講義 (馬場)			
17:00	Q&A (自由参加:馬場)	予備時間	Q&A (自由参加:馬場)	予備時間	Q&A (自由参加:馬場)	予備時間		

座学など (講義室)
実習・見学 (CR、センター内施設)
昼食・休憩

注意: セミナーの進捗状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。